

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2026年2月25日
【会社名】	日本電子材料株式会社
【英訳名】	JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 坂田 輝久
【本店の所在の場所】	兵庫県尼崎市西長洲町二丁目5番13号
【電話番号】	06(6482)2007
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理部門統括部長 石本 浩久
【最寄りの連絡場所】	兵庫県尼崎市西長洲町二丁目5番13号
【電話番号】	06(6482)2007
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理部門統括部長 石本 浩久
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 1,840,207,408円 (注) 募集金額は、発行価額の総額であり、2026年2月17日(火) 現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終 値を基準として算出した見込額であります。
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	260,800株	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。 単元株式数は100株であります。

- (注) 1 2026年2月25日(水)開催の取締役会決議によります。
- 2 本募集とは別に、2026年2月25日(水)開催の取締役会において、当社普通株式1,739,200株の一般募集(以下「一般募集」という。)を行うことを決議しております。また、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の引受人である野村證券株式会社が当社株主から260,800株を上限として借入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といい、一般募集と併せて以下「本件募集売出し」という。)を行う場合があります。
- 3 本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」という。)であります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
- 4 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号

2 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当	—	—	—
その他の者に対する割当	260,800株	1,840,207,408	920,103,704
一般募集	—	—	—
計(総発行株式)	260,800株	1,840,207,408	920,103,704

(注) 1 本募集は、前記「1 新規発行株式」(注) 3に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称			野村證券株式会社
割当株数			260,800株
払込金額			1,840,207,408円
割当予定先の内容	本店所在地		東京都中央区日本橋一丁目13番1号
	代表者の氏名		代表取締役社長 奥田 健太郎
	資本金の額		10,000百万円
	事業の内容		金融商品取引業
	大株主		野村ホールディングス株式会社 100%
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	—
		割当予定先が保有している当社の株式の数 (2025年9月30日現在)	—
	取引関係		一般募集の引受人
	人的関係		—
	当該株券の保有に関する事項		

- 2 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
- 3 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、2026年2月17日(火)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(2) 【募集の条件】

発行価格 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
未定 (注) 1	未定 (注) 1	100株	2026年3月27日(金)	該当事項はありません。	2026年3月30日(月)

- (注) 1 発行価格については、2026年3月10日(火)から2026年3月12日(木)までの間のいずれかの日に一般募集において決定される発行価額と同一の金額といたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を本第三者割当増資の発行数で除した金額とします。
- 2 本第三者割当増資においては全株式を野村證券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
- 3 野村證券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権となります。
- 4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を払込むものとします。

(3) 【申込取扱場所】

場所	所在地
日本電子材料株式会社 本社	兵庫県尼崎市西長洲町二丁目5番13号

(4) 【払込取扱場所】

店名	所在地
株式会社三菱UFJ銀行 尼崎支店	兵庫県尼崎市西難波町四丁目6番25号

3 【株式の引受け】

該当事項はありません。

4 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
1,840,207,408	7,000,000	1,833,207,408

(注) 1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

2 払込金額の総額は、2026年2月17日(火)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額上限1,833,207,408円については、本第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額12,221,812,592円と合わせ、手取概算額合計上限14,055,020,000円について、2028年9月末までに、全額をA I 関連半導体市場の拡大に伴って増加するメモリー向けMタイププローブカード(M E M S技術を用いたプローブカード)への需要に対応した生産キャパシティ拡大のための新工場の建設資金12,500,000,000円の一部又は全部に充当する予定であります。なお、手取概算額の合計額が上記新工場の建設資金を超過した場合、当該超過額を2028年3月末までに半導体検査用部品関連の研究開発費に充当する予定であります。

本資金調達により、今後も拡大が見込まれるMタイププローブカードの開発・生産体制の強化に加えて、次世代半導体向けプローブカードの開発推進を実現し、顧客需要への対応力を向上させ、当社のビジネス拡大に寄与するものと考えております。

今回の調達資金につきましては、上記資金使途に充当するまでの間、当社預金口座にて管理を行います。

なお、今回の調達資金を充当予定の設備投資資金に係る当社の設備計画の内容は、本有価証券届出書提出日(2026年2月25日)現在、以下のとおりであります。

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	投資予定額		資金調達 方法	着手 年月	完了予定 年月	完成後の 増加能力
				総額 (百万円)	既支払額 (百万円)				
提出 会社	〈仮称〉 本社 第2工場 (兵庫県 尼崎市)	半導体検査 用部品関連 事業	プローブカード 生産設備・研究 開発設備	12,500	—	増資資金 (注) 1	2026年 4月	2028年 11月	(注) 2

(注) 1 増資資金で不足が生じた場合は、増資資金及び自己資金での対応を予定しています。

2 生産性の向上のため、生産能力の増加を把握することが困難であり記載を省略しております。

第2 【売出要項】

該当事項はありません。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

オーバーアロットメントによる売出し等について

当社は、2026年2月25日(水)開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、当社普通株式1,739,200株の一般募集(一般募集)を行うことを決議しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の引受人である野村證券株式会社が当社株主から260,800株を上限として借入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。本第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返却に必要な株式を取得させるために行われます。

また、野村證券株式会社は、本件募集売出しの申込期間の終了する日の翌日から2026年3月25日(水)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

更に、野村證券株式会社は、本件募集売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。

オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数(以下「取得予定株式数」という。)について、野村證券株式会社は本第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

野村證券株式会社が本第三者割当増資に係る割当てに応じる場合には、野村證券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行います。

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

第4 【その他の記載事項】

該当事項はありません。

第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項はありません。

第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月24日近畿財務局長に提出

2 【半期報告書】

事業年度 第67期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年11月13日近畿財務局長に提出

3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2026年2月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月26日に近畿財務局長に提出

第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提出日以後本有価証券届出書提出日(2026年2月25日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について変更及び追加がありました。

以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該変更及び追加箇所については_____野で示しております。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(2) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的指標等」に記載されている「経営指標」及び「2026年度目標」については、中期経営計画(進捗状況)の公表日である2025年5月14日現在における経済動向や市場環境をはじめとする情報に基づくものであり、本有価証券届出書提出日(2026年2月25日)現在においては、その後の事業環境等の変化に伴い、中期経営計画(進捗状況)の公表時点とはその前提が異なっております。当該事項及び以下の「事業等のリスク」に記載の事項を除き、当該将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2026年2月25日)現在においてもその判断に変更はなく、また、新たに記載する将来に関する事項もありません。

なお、当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、以下の「事業等のリスク」に記載されたものを含め、その達成を保証するものではありません。

〔事業等のリスク〕

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のある主要なリスクは以下のとおりです。
なお、文中における将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2026年2月25日)現在において当社グループが判断したものです。リスクの全てを網羅したものではなく、事業等のリスクは以下に限定されるものではありません。

(1) 半導体市場の動向に関するリスク

当社グループの売上の大半は半導体検査用部品であるプローブカードであり、半導体の回路毎に設計・製造される消耗品としての特性を有しています。

当社グループは、半導体の回路設計と一体化してプローブカードを迅速に設計、開発するため、国内のみならず、米国、台湾等、海外にも販売・生産拠点を設け、市場動向や顧客ニーズの変化に対応しております。

しかしながら、米国の通商政策や金融資本市場の変動の高まりの影響等、世界的な景気後退リスクが半導体市場及びプローブカード市場に影響を与えた場合、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。

(2) 新製品の開発等に関するリスク

当社グループは、半導体回路の微細化や高速化に向けた、MEMS技術を用いたプローブの性能向上や基板の開発、プローブカードの組立技術や加工技術の開発、次世代半導体向けプローブカードの開発や既存製品の性能向上等、様々な技術や新製品の開発を推進しております。

しかしながら、当社の新製品の開発や技術開発に遅れ等が生じた場合、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。

(3) 特定顧客への販売に関するリスク

半導体ビジネスは、投資コストの増加や需給バランスの不安定さ等の影響により、収益性の向上を図ることが容易ではなくなった結果、半導体メーカーの再編が進み、大手半導体メーカーによる寡占化が進みました。一方で、中長期的には、デジタル社会への移行が世界中で進む中、半導体は、生成AIやデータセンター向けをはじめとして、様々なサービスや製品において需要の拡大が予想されており、それらを背景として、大手半導体メーカーを中心に、新たな半導体工場の建設等、半導体製造基盤の確保・強化に向けた動きも広がっております。当社グループもそれらの影響を受け、売上高における特定顧客が占める比率が高まっております。

それら特定顧客の設備投資の動向や生産計画の変更等は、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。

(4) 製品価格の変動に関するリスク

半導体メーカーは、利益と競争力を維持するためコスト削減を徹底しており、プローブカードに対しても継続した価格要請があり、当社グループは、技術革新やVA活動による原価低減等によって、価格要請に対応するとともに、付加価値の向上を図っております。

しかしながら、価格競争の激化等によって、販売価格がさらに下落した場合、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。

(5) 製品の品質に関するリスク

当社グループでは、厳正な品質管理基準に従い製品の品質信頼性の維持向上に努めているとともに、主要な拠点においてはISO9001の認証を取得する等、品質保証体制の強化を図っております。

しかしながら、予期せぬ製品の欠陥や品質上の問題が発生した場合には、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。

(6) パンデミックや災害等の異常事態に関するリスク

当社グループは、新型コロナウイルス感染症の拡大の際、お客様、お取引先様、従業員とその家族の安全確保・感染予防と感染拡大の防止及び事業継続に向けて、感染予防対策を推進いたしました。加えて、災害等の発生に備えたリスク管理も実施しています。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大のようなパンデミックや地震、火災等の異常事態が当社の予想を超える規模で発生し、事業運営が困難になった場合、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。

(7) 人材確保に関するリスク

当社グループの成長には、電気、機械、化学等の専門知識を持つエンジニアをはじめとする、優秀な人材の確保・育成は重要な課題と認識しており、採用活動の強化、安定的な人材確保に努めております。

しかしながら、必要な人材が確保できない場合には、開発・生産・販売等の業務効率の悪化により、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。

(8) 地政学的リスク

当社グループで取り扱う製品の一部は、海外において販売や生産を行っております。海外展開にあたっては、海外子会社からの報告も合わせて、総合的に判断することとしております。

しかしながら、政治的な緊張の高まり等によって、当該国・地域における、販売や生産が困難になった場合、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。

(9) 為替変動に関するリスク

当社グループは、一層の海外販売の強化を行う方針であります。外貨建ての取引については、為替予約等のリスクマネジメントを行っておりますが、為替相場の変動が当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。

(10) 知的財産権に関するリスク

当社グループは、積極的な研究開発により製品力の強化を図るとともに、知的財産権の取得・維持により、競争力の確保に努めております。

しかしながら、知的財産権の取得・維持ができない場合、あるいは第三者の知的財産権に基づく制約や訴訟を受けた場合には、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。

(11) 情報セキュリティに関するリスク

当社グループは、高度な情報セキュリティレベルを実現すべく、外部専門家の助言を得ながらネットワーク、サーバー、パソコン等への監視体制の強化を図っております。

しかしながら、保有する情報資産が、第三者からの不正通信などにより漏洩・破壊・抹消・改ざんされた場合、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。

(12) 設備投資に関するリスク

当社グループは、市場動向、需要予測及び生産・販売・利益計画等を総合的に勘案して設備投資を計画しております。また、投資後は稼働率や生産効率の向上を図ることにより資産の有効活用に取り組んでおります。

しかしながら、顧客需要の減少や価格競争による製品単価の下落等により十分な収益が見込めなくなり投資額の回収が困難になった場合には、減損損失の認識が必要となり、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。

(13) 特定取引先からの調達及び外部委託に関するリスク

当社グループは、プローブカードの製造にあたり様々な取引先から装置・部材を調達し、また、外部委託を活用しておりますが、これらの一部には代替困難な取引先があります。当社グループでは、このような取引先との良好な関係の維持に努めるとともに、取引先を分散することで、製品の安定的な供給を図っております。

しかしながら、取引先における供給遅延や加工納期遅延、品質問題等が発生した場合には、当社グループの製品の製造中断や品質低下を引き起こし、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を与える可能性があります。

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

日本電子材料株式会社 本社
(兵庫県尼崎市西長洲町二丁目5番13号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

第五部 【特別情報】

該当事項はありません。